DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

AA- 1989-037242/198905| XR- < XRAM > C89-016511|

TI- Liq. curable resin compsn. - contg. polyurethane with polyoxyalkylene structure, ethylenically unsatd. monomer (meth)acrylate and polymerisation initiator

PA- DESOTO INC (DESP.); JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD (JAPS.)

NC- 001 NP- 002

PN- JP 63312309 A 19881220 JP 87146823 A 19870612 198905 B

PN- JP 2522663 B2 19960807 JP 87146823 A 19870612 199636

AN- (LOCAL) JP 87146823 A 19870612; JP 87146823 A 19870612

AN- (PR) JP 87146823 A 19870612

FD- JP 63312309 A

FD- <u>JP 2522663</u> B2 C08F-290/00 Previous Publ. patent JP 63312309

LA- JP 63312309(10); JP 2522663(7)

AB- BASIC> JP 63312309 A

The resin compsn. contains 65–90 wt.% of (A) polyurethane having a polyo-yalkylene structure consisting of at least two types of 2–6C oxyalkylene gps. and ethylenically unsatd. gp., 2–20 wt.% of (B) ethylenically unsatd. monomer having at least one amino gp in the molecul 2–20 wt.% of (C) (meth)acrylate of formula (I) and 0.1–10 wt.% of .D polymerisation initiator. In formula, R1=H or CH3; R2=H or 1–12C alkyl gp.; R3=2–6C alkylene gp.; n=1 to 2 on ave.

(A) is obtd by interaction of diol having the specified polyoxyalkylene structure, cpd. having ethylenically unsatd, gp. and diisocyanate. Pref. diol is e.g. polyoxypropylene-polyoxytetramethylene glycol obtd by copolymerisation of propylene oxide and tetrahydrofuran in a ratio of 60:40 to 5:95 by wt. The polymer has a number ave mol wt. of 3,000–10,000, pref. 3,500–8,000 and contains 50–95 (pref. 70–90) wt.³a of the specified polyoxyalkylene structure and 0.5–10 (pref. 1–8) wt % of the ethylenically unsatd, gp. Pref. (B) and N-vinyl pyrrolidone N-vinyl caprolactam and acryloyl morphorine. Pref. (C) is phenoxyethyl acrylate.

ADVANTAGE – The liq curable resin compsn. has strong adhesion to optical fibre and forms cured product with a Young's modulus of below 5 kg 'mm2 even at about –40 deg.C. It is suitable as covering material for optical fibre.

Dwg.0.70

DE- : TITLE TERMS. LIQUID; CURE; RESIN; COMPOSITION; CONTAIN; POLYURETHANE; POLYOXYALKYLENE; STRUCTURE; ETHYLENIC; UNSATURATED; MONOMER; METHO;

DE- (ADDITIONAL WORDS) POLYMETHACRYLATE

DC- A14: A25: A89

IC- <MAIN> C08F-290/00

IC- <ADDITIONAL> C08F-290/06; C08F-299/00

ACRYLATE: POLYMERISE: INITIATE

MC- <CPI> A05-D; A05-G; A05-G03; A08-C01; A08-C07

FS- CPIII

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2522663号

(45)発行日 平成8年(1996)8月7日

(24)登録日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C08F 290/00	MRX		C08F 290/00	MRX	
290/06	MRS		290/06	MRS	

発明の数1(全 7 頁)

(21)出願番号	特願昭62-146823	(73)特許権者	999999999
			ディーエスエム・エヌヴィ
(22)出顧日	昭和62年(1987) 6月12日		オランダ国,ティーイー・ヘエルレン
			6411, ヘト・オーバールーン 1
(65)公開番号	特開昭63-312309	(73)特許権者	99999999
(43)公開日	昭和63年(1988)12月20日		日本合成ゴム株式会社
			東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	大高 亨
			東京都中央区築地2丁目11番24号 日本
			合成ゴム株式会社内
		(72)発明者	別所 啓一
			東京都中央区築地2丁目11番24号 日本
			合成ゴム株式会社内
		(74)代理人	弁理士 岩見谷 周志
		審査官	藤井 彰
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液状硬化性樹脂組成物

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 炭素原子数2~6のオキシアルキレン基2種以上から構成されるポリオキシアルキレン構造およびエチレン性不飽和基を有するポリウレタン

1

65~90重量%

(b) 分子中にアミノ基を少なくとも1個有するエチレン性不飽和モノマー〔ただし、下記式:

$$CH_2 = CKCO - NO$$

で表わされるアクリロイルモルホリンは除く〕 $2 \sim 20$ 重量%

(c) 一般式(I):

$$CH_{z} = C - C - (OR_{3})_{=0} O - R_{z}$$
(I)

〔式中、 R_1 は水素原子またはメチル基、 R_2 は水素原子または炭素原子数 $1\sim12$ のアルキル基、 R_3 は炭素原子数 $2\sim6$ のアルキレン基であり、n は平均値であって $1\sim2$ である〕

で表わされる(メタ)アクリレート 2〜20重量% (d) 重合開始剤 0.1〜10重量% を含有してなる液状硬化性樹脂組成物。 【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明は液状硬化性樹脂組成物に関し、特に光ファイ バー用被覆材料として好適な液状硬化性樹脂組成物に関 する。

[従来の技術]

光ファイバーの製造においては、ガラスファイバーの 熱溶融紡糸直後に保護補強を目的として樹脂被覆が施さ れている。

この樹脂被覆として、光ファイバー表面にまず柔軟な 第1次被覆層を設けその外側により剛性の高い第2次被 10 覆層を設けた構造がよく知られている。

この第1次被覆層の材料としてはポリエステリ (メ タ) アクリレート、エボキシ (メタ) アクリレート、ウ レタン (メタ) アクリレート等を主成分とする種々の液 状硬化性樹脂組成物が知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、光ファイバーは多様な環境下で使用される ので、例えば−40℃程度においても伝送損失が小さいこ とが求められる。一般に、光ファイバーの被覆材料の柔 軟性が損なわれると伝送損失が増大するので、光ファイ 20 バーの第1次被覆層には−40℃程度の低温においてもヤ ング率が小さく柔軟であることが求められる。一方、光 ファイバーの被覆材料はガラスファイバーを保護補強す るものであるからその第1次被覆層にはガラスファイバ

〔式中、R、は水素原子またはメチル基、R。は水素原子ま たは炭素原子数 1~12のアルキル基、R,は炭素原子数 2 ~ 6 のアルキレン基であり、nは平均値であって $1\sim 2$ である〕

で表わされる (メタ) アクリレート

2~20重量%

(d) 重合開始剤

0.1~10重量%

を含有してなる液状硬化性樹脂組成物。

を提供するものである。

本発明の液状硬化性樹脂組成物(以下、「組成物」と 称す)に用いられる (a) 成分であるポリウレタン(以 下、「ホリマー (a) 」と称す)は、炭素数2~6のオ キシアルキレン基2種以上から構成されるポリオキシア ルキレン構造(以下、「特定のホリオキシアルキレン構 造」と称す)を有するジオール、エチレン性不飽和基を 有する化合物ならびにジイソシアネートを反応させるこ とにより得られる。

以下に、上記のポリマー (a) の製法を例示する。 〔製法1〕

特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオールと ジイソシアネートとを反応させて得られる重合体の官能 基に、エチレン性不飽和基を有する化合物を反応させる 50

ーとの高い密着性も要求される。

しかし、従来の第1次被覆層用の材料は、前記したも のを含め、一般に、光ファイバーとの密着性を高めると 低温におけるヤング率が大きくなるという問題を有して いる。

そこで、本発明の目的は、光ファイバー用被覆材料と して用いた場合に、光ファイバーに対する密着性に優 れ、しかも-40℃程度の低温においても得られる硬化物 のヤング率が5kg/mm²以下と小さい被状硬化性樹脂組成 物を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、前記問題点を解決するものとして、

(a) 炭素原子数2~6のオキシアルキレン基2種以上 から構成されるポリオキシアルキレン構造およびエチレ ン性不飽和基を有するポリウレタン

65~90重量%

(b) 分子中にアミ/基を少なくとも1個有するエチレ ン性不飽和モノマー〔ただし、下記式:

で表わされるアクリロイルモルホリンは除く〕2~20重 量%

(c) 一般式(I):

(I)

方法。

[製法2]

ジイソシアネートとエチレン性不飽和基を有する化台 物を反応させて得られる付加体の官能基に特定のポリオ キシアルキレン構造を有するジオールを反応させる方 法。

〔製法3〕

ジイソシアネート、特定のポリオキシアルキレン構造 を有するジオールおよびエチレン性不飽和基を有する化 台物を同時に反応させる方法。

上記の方法で用いられる特定のポリオキシアルキレン 構造を有するジオールは、例えば、エチレンオキシド、 プロピレンオキンド、テトラヒドロフラン、オキセタ ン、置換オキセタン、テトラヒドロピラン、オキセパン から選ばれる少なくとも2種心化合物を開環共重合する ことにより得られる。

これらの特定のポリオキシアルキレン構造を有するジ オールのうち、プロピレンオキシトとテトラヒドロフラ ンを重量比60:40~5 95で共重台することにより得られ るポリ(オキシプロビレンーオキシテトラメチレン)構 造を有するジオール、例えばポリオキシブロビレンポリ オキシテトラメチレングリコール(以下、「PPTG」と称 する)が、特に好ましい。この場合、プロピレンオキシドとテトラヒドロフランの重量比(プロピレンオキシドノテトラヒドロフラン)が60/40を超えると、組成物の硬化後の耐熱性が悪くなる。また、プロピレンオキシドとテトラヒドロフランの重量比(プロピレンオキシドノテトラヒドロフラン)が5/95より小さくなると組成物の粘度が高くなる。

またボリマー (a) の製造に用いられるジオールとしては、前記特定のボリオキシアルキレン構造を有するジオールとフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、フマール酸、アジピン酸、セバシン酸等の多塩基酸とを反応して得られるボリエステルジオール、前記特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオールとを一カプロラクトンとを反応して得られるボリカブロラクトンジオール等を挙げることができる。

上記特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオールは、例えばユニセーフ DC 1100 (日本油脂 (株) 製)、ユニセーフ 1800 (同)、ユニセーフ DCB 110 (同)、ユニセーフ DCB 1800 (同)、PPTG 4000 (保土ヶ谷化学)、PPTG 2000 (同)、PPTG 1000 (同)等の市販品としても入手することができる。

これらのポリマー (a) は1種単独で用いても2種以上併用してもよい。

これらの特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオールには特定のポリオキシアルキレン構造を有さないジオールおよびでまたはジアミンを、本発明の効果が失われない程度、併用することができる。

特定のポリオキシアルキレン構造を有さないジオール としては、例えばボリエチレングリコール、ボリブロビ レングリコール、ホリテトラメチレングリコール等のボー30 リエーテルジオール:エチレングリコール、ポリエチレ ングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレン グリコール、テトラメチレングリコール、ポリテトラメ チレングリコール、1.6-ハキサンジオール、ネオペン チルグリコール、1,4-シクロペキサンジメタノールの ような多価アルコールとフタル酸、イソフタル酸、テレ コタル酸、マレイン酸、コマール酸、アジビン酸、セバ シン酸のような多塩基酸とを反応して得られるポリエス デルジオール:水酸基を1分子中に2個有する液状ポリ プタジエンまたはこの化台物の水添物:εーカプロラク 40 トンと、エチレングリコール、ポリエチレングリコー ル、ホリプロビレングリコール、テトラメチレングリコ ール、ポリテトラメチレングリコール、1.6ーベキサン ジオール、ネオペンチルグリコール、1,4~シグロベキ サンチスタノール、1,4-プタンジオール等の2価のジ オールを反応させて得られるポリカプロラクトンジオー ル、DN-980 (日本ポリウレタン (株))、DN-981

(同)、DN-982(同)、DN-983(同)、PC-8000(米 国PPG社)等の商品名で表わされるポリカーボネートジ オール等を挙げることができる。

これらの特定のポリオキシアルキレン構造を有さない ジオールおよびジアミンはそれぞれ1種単独で用いて も、2種以上併用してもよい。

> ジイソシアネート化合物としては、2,4~トリレンジ イソシアネート、2,6~トルエンジイソシアネート、1,3 ーキシレンジイソシアネート、1,4ーキシレンジイソシ アネート、1、5ーナフタレンジイソシアネート、mー フェニレンジイソシアネート、pーフェニレンジイソシ アネート、3,3′ージメチルー4,4′ージフェニルメタン ジイソシアネート、4,4′ージフェニルメタンシイソシ アネート、3,3′ージチメルフェニレンジイソシアネー ト、4,4′ーピフェニレンジイソシアネート、ヘキサメ チレンジイソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、メチレンピス(4ーシクロヘキシルイソシアネート、ト)等が挙げられる。

これらのジイソシアネートは1種単独で用いても、2 種以上併用してもよい。

さらに、エチレン性不飽和基を有する化合物として は、例えば、水酸基、酸ハライド基またはエボキシ基を 有する(メタ)アクリル系化合物を挙げることができ る。

水酸基を有する(メタ)アクリル系化台物としては、 例えば2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2 ーヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、2ーヒド ロキシオクチル (メタ) アクリレート、ペンタエリスリ トールトリ(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メ タ) アクリレート、ジベンタエリスリトールモノヒドロ キシベンタ(メタ)アクリレート、1,4~ブタンジオー ルモノ (メタ) アクリレート、4-ヒドロキシシクロペ キシル (メタ) アクリレート、1,6-ハキサンジオール モノ (メタ) アクリレート、ネオベンチルグリコールモ - / (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバンジ (メタ) アクリレート、トリメチロールエタンジ (メ タ) アクリレート、アルキルグリシジルエーテル、アリ ールグリシジルエーテル、グリシジル(メタ)アクリレ ート等のグリシジル基含有化台物と(メタ)アクリル酸 との付加反応により得られる化合物、および下記の構造 式で表わされる (メタ) アクリレートを挙げることがで きる。

$$R_{1}$$

$$CH_{z} = C - C - 0 - CH_{z}CH - CH_{z} - 0$$

$$0 OH$$

$$R_{1}$$

$$CH_{z} = C - C - 0 - CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}H_{z}CH_{$$

30

(式中、 R_i は水素原子またはメチル基であり、nは $1\sim$ 5である)

エポキシ基を有する (メタ) アクリル系化合物としては、 (メタ) アクリル酸のグリシジルエステル等が挙げられる。

酸ハライド基を有する(メタ)アクリル系化合物としては、(メタ)アクリル酸クロライド、(メタ)アクリル酸プロマイド等の(メタ)アクリル酸ハライドを例示することができる。これらのエチレン性不飽和基を有する化合物は1種単独で用いても、2種以上併用してもよ 20 い。

次に上記製法1の好ましい実施態様を示す。

特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオールの水酸基1当量あたりのジイソシアネートの使用量は、約0.5~2モルである。この反応においては、通常、ナフテン酸銅、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛、ラウリル酸カーブチルスズ、トリエチルアミン等の触媒を反応物の総量100重量部に対して0.01~1.0重量部用いて反応を行う。この反応における反応温度は、通常、0~80である。

このようにして得られる中間生成物の官能基に対して エチレン性不飽和基を有する化合物を反応させるが、エ チレン性不飽和基を有する化合物の使用量は、該中間生 成物の官能基1当量に対して約1モルであり、その反応 条件は、前記の中間生成物をつくる反応条件と同様である

次に上記製法2の好ましい実施態様を示す。

ジイソシアネート1モルに対してエチレン性不飽和基を有する化合物約1モルを製法1と同様の反応条件で反応させて得られる中間生成物の官能基1当量に対して特 40 定のボリオキシアルキレン構造を有するジオールの水酸基が約1当量となるように使用し、製法1と同様の反応条件で反応させる。

次に上記製法3の好ましい実施態様を示す。

特定のポリオキシアルキレン構造を有するジオール1 モルに対してジインシアネート0.5~2モルおよびエチレン性不飽和基を有する化合物0.5~2モルを製法1と 同様の反応条件で反応させる。

上記製法 $1\sim3$ の実施に際しては、ジオールに対して カプロラクタム、アクリルアミド、N,Nージメチルアクニ官能以外のホリオール、ジアミンに対して二官能以外 50 リルアミド、N,Nージメチルアミノブロピルアクリルア

のポリアミンまたはジイソシアネートに対して二官能以 外のポリイソシアネートを生成物がゲル化しない程度に 併用することができ、通常、その併用量は、ジオール、 ジアミンまたはジイソシアネート100重量部に対して5 ~30重量部である。ここにおける二官能以外のポリオー ルとしては、例えばグリセリンとプロビレンオキサイド の付加生成物、グリセリン、1,2,3-ペンタントリオー ル、1,2,3-ブタントリオール、トリ(2-ヒドロキシ ホリオキシプロピル) ポリシロキサン、ポリカプロラク トントリオール、ポリカプロラクトンテトラオール、1 分子中に2個を超える数の水酸基を有する液状ポリプタ ジエンまたはこの化合物の水添物等を挙げることができ る。二官能以外のポリアミンとしては、例えばジエチレ ントリアミン、1,2,3-トリアミノプロパン、ボリオキ シプロピレンアミン等を挙げることができ、二官能以外 のポリイソシアネート化合物としては、例えばポリメチ レンポリフェニルイソシアネート、トリフェニルメタン 4,4',4"-トリイソシアネート等を挙げることができ る。

本発明において、ポリマー(a)の総量に対する特定のホリオキシアルキレン構造の割合は、通常、50~95重量%、好ましくは70~90重量%、エチレン性不飽和基の割合は、通常、0.5~10重量%、好ましくは1~8重量%である。

また、ボリマー(a)は、通常、数平均分子量が3000~10000であり、3500~8000であることが好ましい。この数平均分子量が、3000未満であると得られる硬化物の低温におけるヤング率が上昇し、10000を超えると組成物の粘度が上昇し光ファイバーに対する塗工性が低下する。また、ボリマー(a)の組成物中に占める割合は、65~90重量であることが必要であり、70~85重量であることが必要であり、70~85重量であることが必要であり、70~85重量であることが必要であり、70~85重量であることが必要であり、70~85重量であることが必要であり、70~85重量であることが好ましい。この組成物中に占める割合が65重量で未満であると、低温における硬化物のヤング率が上昇し、90重量でを超えると光ファイバーに対する塗工性が低下する。

本発明の組成物に用いられる(b)成分の分子中にアミノ基を少なくとも1個有するエチレン性不飽和モノマーとしては、例えばNーピニルピロリドン、Nーピニルカブロラクタム、アクリルアミド、N.Nージメチルアミノブロピルアクリルア

ミド、オクチルアクリルアミド、N,N-ジメチルアミノ エチルアクリレート、N.N-ジエチルアミノエチルアク リレート等の第3級アミノ基を有するモノエチレン性不 飽和モノマーが挙げられる。これらのうち、Nーピニル ピロリドン、N-ピニルカプロラクタム、比較的人間の

皮ふに対する刺戟が少ないので好ましい。 これらの分子中にアミノ基を少なくとも1個有するエ

チレン性子飽和モノマーは1種単独で用いてもよいし、 2種以上併用してもよい。

であることが必要であり、3~12重量%であることが好 ましい。この(b)成分の割合が2重量%未満である。 と、得られる硬化物の光ファイバーに対する密着性が低 下し、20重量%を超えると、硬化物の吸水率が高くな る。

本発明の組成物に用いられる(c)成分の(メタ)ア クリレートを表わす一般式(I)において、Ryで表わさ れる炭素数1~12のアルキル基としては、例えば、メチ ル基、エチル基、プロピル基、ヘキシル基、ノニル基 等、好ましくは水素原子、メチル基、エチル基等が挙げ 20 られ、R.で表わされる炭素数2~6のアルキレン基とし ては、メチレン基、エチレン基、プロビレン基、テトラ メチレン基、プチレン基、パンタメチレン基、ヘキサメ チレン基等が挙げられる。また、一般式(1)において nが2を超えると得られる硬化物の光ファイバーに対す る密着性が低下する。

(c) 成分の一般式(I) で表わされる(メタ)アク リレートとしては、フェノキシエチル (メタ) アクリレ ート、フェノキシジエチレングリコール(メタ)アクリ レート、フェノキシプロビル (メタ) アクリレート等が 30 挙げられ、市販品としてはアロニクスM101 (東亜台成 (株) 製), アロニクスM111 (東亜台成(株)製)等が 挙げられる。

これらの(c)成分のうちではフェノキシエチルアク リレートが好ましい。

(c)成分の組成物中に占める割合は、2~20重量% であることが必要であり、3~12重量%であることが好 ましい。この (c) 成分の割合が2重量%未満である と、組成物の硬化速度が遅くなり、20重量%を超える と、硬化物の低温におけるヤング率が大きくなる。

本発明の組成物に用いられる(オ)成分として用い得 る光重台開始剤は、特に限定されず、例えば、1-ヒド ロキシシグロイキシルフェニルケトン、2,2-ジメトキ ショヒーフェニルアセトフェノン、アセトフェノン、イ シソフェフン、キサントン、フルオレフン、ベンズアル デヒド、フルオレン、アントラキ /ン、トリフェニルア ミン、カルバプール、3・メチルアセトフェノン、4-クロロベンゾフェノン、4.4′ = ジメトキシベン ゾフェ ノン、4、4′ - ジアミノベンゾフェ /ン、ミヒラーケト

ーテル、ペンジルジメチルケタール、1-(4-イソブ ロピルフェニル)ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロバ

シー1ーすン、2~ヒドロキシー2-メチルー1-フェ 二ルプロパン・1ーオン、チオキサントン系化合物、2 - メチルー1~〔4~(メチルチオ)フェニル」~2~ モルボリノープロパン・1ーオン、2,4,6~トリメチル

10

ィングイルジフェニルフォスフィンオキサイド等が挙げ られる。

本発明の組成物に使用される(d)成分として用い得 (b) 成分の組成物中に占める割合は、 $2 \sim \!\! 20$ 重量% 10 る熱重台開始剤も特に限定されず、種々のものを使用す ることができ、例えば過酸化物、アゾ化合物を挙げるこ とができ、具体例としては、ペンソイルバーオキサイ ド、モーブチルパーオキシベンゾエート、アゾピスイソ ブチロニトリル等を挙げることができる。

> これらの重台開始剤は、1種単独で用いてもよいし、 2種以上を併用してもよく、また光重台開始剤を用いる 場合には必要に応じてアミン系化合物等の増感剤(光重 台促進剤)を併用することができる。

> (d) 成分の組成物中に占める割台は、0.1~10重量% であることが必要であり、2~5重量%であることが好 ましい。この(d)成分の割合が0.1重量%未満である と、組成物の硬化速度が遅くなり、10重量%を超える と、組成物の保存安定性、硬化後の耐熱耐汚水性が低下 する。

本発明においては前記(a)~(d)成分以外にシラ ンカップリング剤、例えばァーメタクリロキシブロビル トリメトキシシラン、アーグリシドキシブロビルトリメ トキシシラン、アーメルカプトプロピルトリメトキシシ ラン、 アークロロプロピルトリメトキシシラン、アー (2-アミノエチル) アミノプロビルトリメトキシシラ ン、デーメタクリロキシブロビルトリエトキシシラン、 γ - グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ - メ ルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ-クロロプロ ピルトリメトキシシラン、アー(2-アミノエチル)ア ミノブロピルトリエトキシシラン等を、組成物中に含ん でいてもよい。これらのシランカップリング剤の組成物 中に占める割合は、通常、0.1~5重量%であり、0.3~ 3重量でであることが好ましい。このシランカップリン グ剤の割合が0.1重量%未満であると、湿度が高い場合 40 には得られる硬化物の光ファイバーに対する密着性が低 丁し、5重量%を超えると、組成物の保存安定性が低下

また、本発明の組成物には、必要に応じて他の添加剤 を使用することができ、例えば、エチレン性子飽和基を 有する前記(b), (c) 成分以外の反応性希釈剤、老 化防止剤、重合禁止剤、レバリング剤等を配合すること ができる。

エチレン性不飽和基を有する(b), (c) 成分以外 の反応希釈剤は、本発明の組成物の硬化性、得られる硬 シ、インペインプロビルエーテル、インペインエチルエー50 化物の力学特性等に悪影響を及ぼさない範囲で使用する

ことができる。このような反応性希釈剤は、特に制限さ れず、例えば2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシブロピルアクリレート、テトラヒドロフルフ リルアクリレート、プトキシエチルアクリレート、エチ ルジエチレングリコールアクリレート、イソボルエルア クリレート、2-エチルベキシルアクリレート、シクロ ハキシルアクリレート、ジシクロベンタジエンアクリレ ート、ホリエチレングリコールアクリレート、ポリプロ ピレングリコールアクリレート、メチルトリエチレング リコールアクリレート、アーアミノー3,7ージメチルオ クチルアクリレート、2-ヒトロキシエチルメタクリレ ート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、ポリブ ロピレングリコールメタクリレート、ジエチルアミノエ チルメタクリレート、トリメチロールプロパントリアク リレート、エチレングリコールジアクリレート、テトラ エチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリ コールジアクリレート、1,4-プタンジオールジアクリ レート、1.6ーヘキサンジオールジアクリレート、ネオ ベンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールブ ロバントリオキシエチルアクリレート、トリメチロール 20 実施例2 プロパントリオキシプロビルアクリレート、ピニルフェ ノール、アクリルアミド、酢酸ピニル、ピニルエーテ ル、スチレン等が挙げられる。

このようにして調製される本発明の組成物の粘度は、 通常、1000~20000cP/25℃、好ましくは2000~10000cP/ 25℃であり、硬化後のヤング率は、通常、0.01~0.7kg/ mm'(温度23℃)である。

本発明の組成物を光ファイバーに施して第1次被覆層 を形成するには、例えば、紡糸直後にガラスファイバー の表面に組成物を硬化後の膜厚が10~200μm程度とな るように適宜な方法で塗工した後、紫外線、電子線等の 放射線を照射して、または加熱して組成物を硬化させれ ばよい。

こうして得られた柔軟な第1次被覆層の外側により剛 性の高い第2次被覆層を設ける場合には、さらに、第1 次被覆層の上にポリアミド樹脂、液晶ポリエステル樹脂 や一般の熱硬化型または紫外線ないし電子線硬化型材 料、例えば、ポリエステル (メタ) アクリレート、エボ キシ (メタ) アクリレート、ウレタン (メタ) アクリレ ート等を塗工しこれを硬化させればよい。 実施例

口下本発明を実施例により更に具体的に説明するが、

本発明は、これら実施例に限定されるものではない。な お、実施例中「部」は重量部を意味する。

実施例1

攪拌機を備えた反応容器に、2,4-トリレンジイソシ アナート81.46g、ジブチル錫ジラウレートlgおよび重合 禁止剤である2,6ージェープチルー4ーメチルフェノー ル1gを仕込んだ。これに数平均分子量3700のポリオキシ プロピレンボリオキシテトラメチレングリコール (商品 名PPTG4000,保土谷化学(株)製)864.23gを内温を40~ 10 50℃に保持しながら2時間にわたって添加した。添加終 了後、更に、40~50℃で1時間攪拌を続けた。その後、 ヒドロキシエチルアクリレート54.31gを内温を40~50℃ に保持しながら添加して、(a)成分である数平均分子 量4300のポリマー(A)を得た。

次に上記ポリマー (A) 75部に対しフェノキシエチル アクリレート8部、N-ピニルピロリドン10部、ペンジ ルジメチルケタール5部、ァーメタクリロキシプロピル トリメトキシシラン2部を均一に混合して、25℃におけ る粘度が7500cPの組成物を得た。

実施例1において、フェノキシエチルアクリレートの 使用量を8部から13部に、N-ビニルピロリドンの使用 量を10部から5部に変えた以外は実施例1と同様にし て、25℃における粘度が9500cPの組成物を得た。 実施例3

実施例1において、フェノキシエチルアクリレート8 部の代りにアローニックスM101 (商品名、東亜合成化学 (株)製)8部を用いた以外は、実施例1と同様にして 25℃における粘度が10000cPの組成物を得た。

30 実施例 4

実施例1においてNービニルピロリドン10部の代りに N-ピニルカプロラクタム10部を用いた以外は、実施例 1と同様にして25℃における粘度が9000cPの組成物を得

比較例1

実施例1において前記ポリマー (A) の使用量を75部 から60部に、フェノキシエチルアクリレートの使用量を 8部から23部に変えた以外は、実施例1と同様にして25 てにおける粘度が3000cPの組成物を得た。

40 比較例 2

実施例1においてフェノキシエチルアクリレート8部 の代りに式:

$$CH_{z} = CH - C - (0 - CH_{z}CH_{z}) + C_{\varphi}H_{\varphi}$$

で表わされるアローニクスMI13(商品名、東亜合成化学 (株) 製) 8部を用いた以外は実施例1と同様にして、 25℃における粘度が14000cPの組成物を得た。

試驗例

上記実施例および比較例で調製した各組成物につい て、下記の方法で基材に対する密着性および硬化物のヤ ング率を測定した。結果を表1に示す。

50 密着性の測定

- (i)組成物を石英板上に硬化後の厚さが0.2mmとなるように塗布した後、その上に合計照射エネルギーがIJ/c㎡に相当する紫外線をメタルハライドランブを用いて照射し、硬化皮膜を得た。
- (ii) 石英板上の硬化皮膜を幅1cmのテープ状に石英板上に残し、硬化皮膜の一端を石英板に対して垂直方向に引張って剥離させ、剥離に要する力を測定しその平均値を硬化皮膜の石英板に対する密着力として評価した。 ヤング率の測定

密着性の評価試験と同様にして石英板上に形成した硬 10 ものである。 化皮膜を幅6mmのテーブ状に残し、剥離したものを試料 本発明の組 とし、JIS K6911に規定の引張試験法により標線間25mm 石英に対する で23℃および-40℃におけるヤング率を測定した。 グ率が小さく

表 1

	実施例			比較例		
裁践	1	2	3	4	1	2
密着力(g)	50	20	35	30	90	8
ヤング率 23℃ (kg/或)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	_

	実施例			比較例		
試験	1	2	3	4	1	2
ヤング率 -40℃ (kg/mi)	4	3	3	4	25	_

14

[発明の効果]

本発明の組成物は、種々の放射線、例えば、電子線、 紫外線、可視光線等により、または加熱により硬化する ものである。

本発明の組成物から得られる硬化物は、基材、例えば 石英に対する密着性に優れ、しかも広い温度範囲でヤン グ率が小さく、例えば-40℃程度の低温においてもヤン グ率が5kg/mm'以下と著しく優れたものである。

したがって、本発明の組成物は、光ァイバー用被覆材料として優れたものであり、また種々基材の被覆材料等としても優れたものである。

フロントページの続き

(72)発明者 五十嵐 勝利

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本

合成ゴム株式会社内

(72)発明者 布施 和雄

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本

台成ゴム株式会社内

(72)発明者 クライヴ・コウデイ

アメリカ合衆国, イリノイ州 60195,

ハノーバー・パーク、ピクター・レイン

1875

(72)発明者 ブライアン ハンラハン

アメリカ合衆国、イリノイ州 60195, シアウムブルク、エー・ピー・ティー、 2-0, イー・アルゴンキアン ロード

1304

(56)参考文献 特開 昭61-98716 (JP, A)

特開 昭61-133275 (JP, A)

特開 昭63-130608 (JP, A)